

# 財政統計通報

(第 20 號)



財政部統計處

109 年 10 月 29 日

撰稿人：李震宇研究員

聯絡人：梁冠璇科長

聯絡電話：(02)23228341

## 我國生產半導體等機械出口連續 8 年創新高，取代工具機成為機械類最大出口品項

1. 隨美、中及日、韓之間政經爭端轉化為科技較勁以來，各國對自身科技力之提升益發著重，尤其在涉及利益最大且競爭激烈的半導體產業鏈。我國在晶圓代工與封測領域技術執世界之首，近年來政府致力支持半導體製造及機械產業發展，加上國內半導體領頭企業亦積極培養週邊配合的機械廠商提高自製能力，國內生產半導體等機械出口自 102 年起已連續 8 年創新高，本(109)年 1-9 月出口為 25 億美元，占總機械出口 15.7%，9 年間上升 10.2 個百分點，擠下工具機成為主要機械出口品項。國內業者不斷研發新製程，亦帶動相關生產半導體等機械進口遽增，本年 1-9 月進口 123 億美元，占總機械進口 5 成 3，進、出口兩相比較，國產半導體設備製造業仍有成長空間。

### 我國生產半導體等機械出/進口金額、占比及年增率

單位：億美元；%

貨品別		100年	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年	108年	109年 1-9月
生產半導體 等機械出口	金額	12.0	11.2	13.3	14.6	14.9	17.3	28.1	31.3	32.2	24.8
	占比(1)	5.5	5.2	6.4	6.6	7.2	8.6	11.8	12.3	13.7	15.7
	年增率	24.7	-6.1	18.7	9.4	2.0	16.0	62.7	11.5	2.9	3.9
金屬加工 工具機出口	金額	40.1	42.7	35.6	37.7	32.1	29.0	33.4	36.6	30.7	15.8
	占比(1)	18.4	19.9	16.9	16.9	15.5	14.5	14.0	14.3	13.0	10.0
	年增率	34.9	6.4	-16.6	6.0	-15.0	-9.6	15.3	9.5	-16.1	-32.4
生產半導體 等機械進口	金額	106.5	100.9	119.4	102.1	104.5	141.2	124.7	116.9	193.7	123.3
	占比(1)	41.8	45.6	49.6	43.5	45.1	52.1	47.9	44.3	56.4	53.0
	年增率	-18.6	-5.3	18.4	-14.5	2.3	35.2	-11.7	-6.3	65.6	-1.6

附註：(1)指占總機械出、進口之比重。

2. 日本、美國、荷蘭為世界前 3 大生產半導體等機械出口國家，出口市場多集中於中國大陸、中華民國及南韓，109 年上半年三地合計占比均高逾 7 成，其中荷蘭對中國大陸出口落入第 4 位，主要係因美國管制荷商出售極紫外光光刻機(EUV)給陸商所致。南韓因國內半導體製造巨擘長期扶植該國產業鏈設備商，出口規模位居全球第 5，產品近 7 成出口至中國大陸，我國半導體機械設備製造發展之起步較晚，除外商產製之設備外，出口以中低階製程設備及零件為主，主要出口至中國大陸(占 42%)、美國(占 15%)及日本(占 11%)。全球前 3 大進口國依序為中國大陸、中華民國及南韓，中國大陸為提升半導體自製率，近年相關設備進口值均高居全球首位，主要自日本與南韓進口，我國因開發高階新製程及擴大產能，投資居次，南韓因記憶體價格滑落，放緩投資步調，居第 3。

### 109 年上半年生產半導體等機械主要出口國家之相關統計

單位：億美元；%

世界排名 及出口值	1	2	3	4	5	6	
	日本 107	美國 91	荷蘭 67	新加坡 53	南韓 43	中華民國 16	
出口 市場 排名	1	中國大陸 32.7	南韓 28.6	南韓 33.8	中國大陸 27.0	中國大陸 68.0	中國大陸 41.9
	2	中華民國 22.3	中國大陸 23.9	中華民國 26.0	南韓 22.1	中華民國 7.9	美國 14.9
	3	南韓 20.9	中華民國 19.7	美國 18.2	中華民國 19.6	美國 7.2	日本 10.8
	4	美國 15.8	日本 9.3	中國大陸 17.3	日本 11.7	日本 5.3	新加坡 10.6
	5	新加坡 1.9	荷蘭 5.2	日本 1.1	美國 10.6	新加坡 4.5	荷蘭 8.7
	6	以色列 1.5	新加坡 4.9	德國 0.9	馬來西亞 3.7	越南 2.6	南韓 7.5

資料說明：生產半導體等機械係指 HS code 8486，金屬加工工具機係指 HS code 8456~8463。